

QUY TRÌNH + LỆNH SẢN XUẤT

KINH DOANH

KINH DOANH									LỆNH SỐ:	T-03963/25
KHÁCH HÀNG:	TÂN THÀNH ĐẠT		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:			10/10/2025	
PO :	TTD-071025-040-TGVT		TÂN THÀNH ĐẠT			NGÀY GIAO:			18/10/2025	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT		
BEX-250923-PO0876-H0250M TOUGH MARINE	LOGO SILICON ÉP LÊN BTP	18-4434 TCX-Nền dày 2mm White/Dày 1mm	63,5MM	LOGO SILICON ÉP LÊN BTP	450		452	PCS		
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					450		452	PCS		



PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN

CD 1	NGUYỄN LIỆU	DỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
DÙC SILICON	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có sơn xanh. 2. Silicon nền màu 18-4434 TCX 3. Silicon borm White 4. Keo TQ 5. Tay móng 6. Tap long không keo + vải lót	2: 8g 3: 2g 4: 15cm*15cm/4pes 5: 15cm*15cm 6:1m/ca NĂNG SUẤT: 180PCS/CA	QUY TRÌNH PHA MỰC 18-4434 TCX KD 1380 : 100g RG 101 : -0,25g RG 401 : -2g RG 804 : -0,25g Tăng bám 3#: -10g QUY TRÌNH MÁY DÙC -Nhịt độ thượt trên : 95 độ -Nhịt độ thượt dưới : 145 độ +Vacuum time : 10s +Exhaust timer : 6s +Vulcan timer : 40s +Lực ép PSI : 500 B1: Borm sicc vào khuôn B2: Tháo gỡ miếng tráng của lớp keo và phủ keo lên khuôn(dùng bề mặt keo) B3:Bổ khuôn vào máy ép B4: Khi máy ép xong tháo gỡ ba via sicc trên khuôn nhanh nhất B5: Bổ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đúc và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước và mặt keo. Sau đó nhập kho						
CD 2	NGUYỄN LIỆU	DỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
ÉP cao tần	1. Silicon dã kiểm 2. Miếng lót vàng cách điện 3. Vải xanh cách điện 4. Giấy bông cách điện 5. Khuôn nhôm ép cao tần	2+3+4: 1m mỗi ngày	Điện : 0.3a <input type="checkbox"/> Nhiệt độ : 150 độ c Hơi : 1,5kg Thời gian ngắn điện : 6s Thời gian ngắn : 20s						

CHUẨN BỊ NGUYỄN LIỆU

STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYỄN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Dã có	Chưa có		

Giám đốc

Người lập phiếu ký